

バック・ツー・ザ・フューチャ・半導体 その16

日米半導体協定の終結

ー 7月33日の決着

世界半導体会議への道

テクノビジョン代表 牧本次生（元ソニー専務・元日立専務）

1996年は日本半導体業界にとっても私自身にとっても多難の幕開けとなった。前年の好況から一転、大不況の年となったのだ。しかも10年前に締結された日米半導体協定の最終年に当たっており、電子機械工業会(EIAJ)と米国の半導体工業会(SIA)との間で終結交渉が行われることになっていた。私はEIAJの電子デバイス委員長を務めていたので、業界を代表して終結交渉の一員に加わることになった。社内においては不況対策、社外にあっては日米協定終結交渉のための奔走で忙殺される年になったのだ。

さて、1986年に始まった「日米半導体協定」は日本の半導体業界にどのような影響をもたらしたのであるだろうか？

(1) 外国製半導体のシェア

協定期間中の10年間で、日本国内における外国製半導体のシェアが劇的に向上した。86年当時10%弱であったシェアが88年には10%に達した。92年には20%を超え、さらに2000年には30%を超えた。02年以降は35%を超えてさらに上昇傾向にある。このようなシェアの変化がすべて半導体協定によるものであるとはいえないが、協定が弾み車のような役割を果たしたことは否めないところである。

(2) ダumping防止

協定の一環として導入されたメモリのFMV(公正市場価格)制度は、韓国メーカーの急伸を後押しする形になった。韓国ではちょうどこの時期に、三星電子を筆頭にDRAMの立ち上げが始まっていた。韓国製DRAMは日本では「外国製」ということで大いに受け入れられ、またFMVの制限を受けないので価格設定を自由に行うことができ、世界市場で大いに販路を拡大したのだ。

次頁に示す図1のように、87年から01年に至る14年間で日本製DRAMの世界市場シェアは約75%から約20%と急速に低下し、逆に韓国製DRAMは約5%から40%強へと急伸した。この過程で98年に日韓のシェアが逆転し、それ以来韓国はDRAM王国になったのである。もちろん、この逆転の原因を半導体協定のみを求めることはできない。韓国メーカーの努力や積極性、日本メーカーの消極性、市場構造の転換(メインフレームからパソコンへ)などの要因も考慮に入れなければならないが、協定がそのトリガーになったこともまた事実であろう。

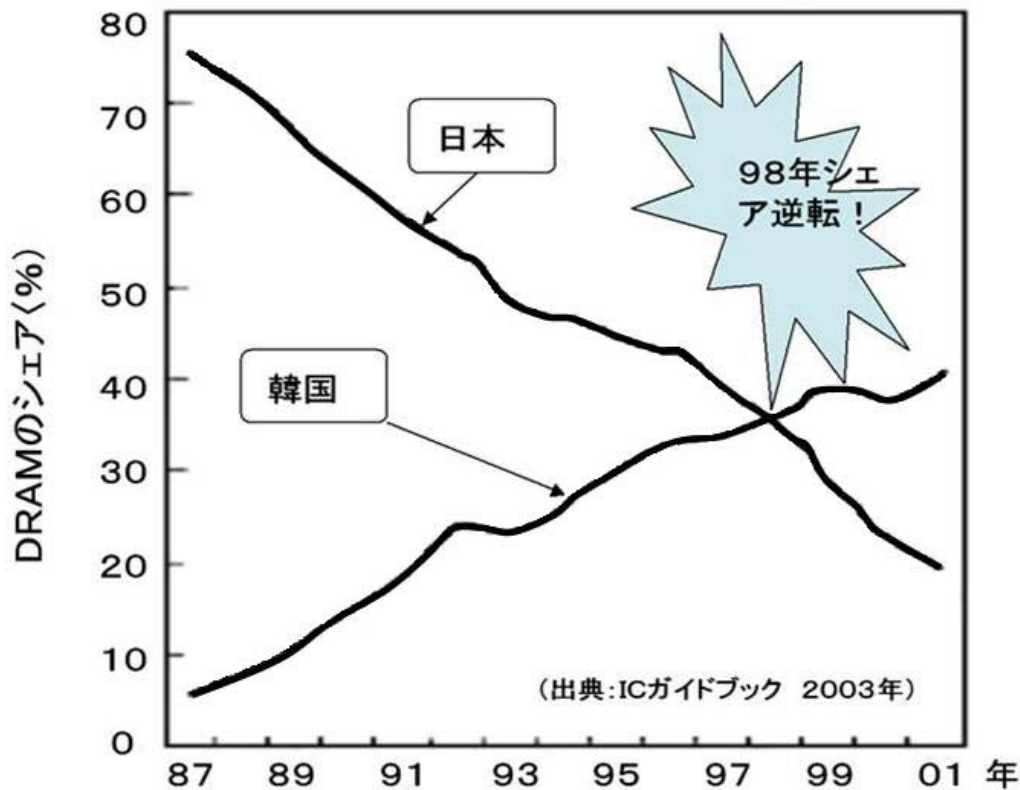


図1 DRAM シェアの推移

(3) 米国半導体の復権

86年の日米半導体協定の締結を契機として、米国では政府と産業界が文字通り一丸となって半導体の強化策に乗り出した。翌87年には半導体共同開発機関としてSEMATECH(セマテック)が設立され、政府からは年間一億ドルの支援がなされた。日米半導体協定とセマテックの設立という二つのイベントを契機として、米国半導体の競争力は驚異的に改善された。93年にはついに日本を再逆転して世界トップのポジションを確立したのである。

このような状況を背景にして半導体協定の終結交渉が96年2月に始まった。日米の政府間交渉と並行して業界間の交渉(SIA 対 EIAJ)を行うという、従来にない進め方である。この案件は日米両政府のトップの関心事でもあり、当時のクリントン大統領と橋本総理大臣の会談において、「交渉のタイムリミットは7月末日」ということが決められていた。交渉の実務部隊としては、何としても「7月末日」という期限内に決着をつけることが至上命題であったのだ。

米国側ではSIAから4人の交渉団が選ばれ、その代表はTI社のパット・ウェーバ氏である。日本からはEIAJ(日本電子機械工業会)の大賀典雄会長(当時、ソニー会長)をトップにして、同じく4人のメンバーが選ばれ、私もデバイス側の代表として交渉団に加わることになった。最終交渉を含めて5回に及ぶ会合が持たれたが、この経過を手記風に綴ることにする。

第1回交渉：2月23日、ハワイにて

EIAJ と SIA メンバーの最初の顔合わせと基本スタンスの確認。現協定は7月末で終結させることを相互に確認し、その後の民間協力の枠組みについて今後詰める。初めての顔合わせでもあり、お互いに様子見の感じもあって友好的な雰囲気でのスタートとなった。

第2回交渉：4月26日、ハワイにて

政府関与のあり方で激しく対立。米側はシェア・モニター、ダンピング防止の面で最低限の政府関与が必要と主張したが、日本側は新しい枠組みでは政府関与は不要であり、市場原理にゆだねるべきと主張した。一時、険悪なムードとなり決裂の気配も合ったが、大賀氏とウエーバ氏の個別会談で交渉をつなぐことで合意した。

第3回交渉：6月24日、電話会議

5月31日にEIAJが出したポジション・ペーパーと6月14日にSIAが出したポジション・ペーパーについての説明と質疑応答。日本からは民間協力の枠組みとして「世界半導体会議」を中心とする多極的な枠組みを提案したのに対し、米側は日米中心の二極体制を維持すべきと主張。電話会議は平行線のままで終わることになった。

この電話会議において次回の交渉日時を7月20日として、場所はカナダのバンクーバで行うことを取り決めた。タイムリミットの「7月末日」も迫っており、交渉がいよいよ山場にかかるタイミングであったが、ここで予期せぬ大事が持ち上がった。

この会談の直前に、日本側交渉団のリーダーとなっていた大賀氏が急に体調を崩して入院されたのだ。そして入院中の大賀氏から私に直接の電話が入り、今度の交渉には出られないので、日本側交渉団のリーダーを務めて欲しいと依頼されたのである。寝耳に水のことだったが、もう後戻りはできない状況であり、この大役をお引き受けする決心をした。

第4回交渉：7月20日、バンクーバにて

日本側のメンバーは私の他に東芝の大山昌伸氏(デバイス側)、三菱電機の新村拓司氏(ユーザー側)、NECの小野敏夫氏(ユーザー側)の4人。図2はこのミーティングに出席した日本側交渉団の写真である。



図2 バンクーバにおける日本側交渉団

左から大山氏(東芝)、牧本(日立)、新村氏(三菱)、小野氏(NEC)

米国側はリーダーのパット・ウェーバ氏の他に、LSI ロジックのウィルフ・コリガン氏、モトローラのトミー・ジョージ氏とマイクロンのスティーブ・アップルトン氏。いずれも、知る人ぞ知る、業界の論客である。

定刻の午前9時にミーティング開始。議論は次第に熱気を帯びてくる。時間の節約のため、昼もワーキング・ランチの形で進められ、午後7時まで延々10 時間にも及ぶ議論が行われた。しかし話せば話すほど別の新しい問題が出てきて双方の主張は集約するというよりもむしろ発散する形になってしまったのだ。

この時の双方の言い分を整理してみよう。

日本側の言い分：

10年に及ぶ半導体協定によって日本国内における外国製品のシェアは当初目標の20%をはるかに超えており、ダンピングも起こっていない。協定の目的は十分に達成された。今後、両国政府の関与は不要であり、市場原理にゆだねたい。また、従来の日米二極の枠組みに代えて、多極的な「世界半導体会議 (World Semiconductor Council; WSC)」の設立を提案する。

米側の言い分：

半導体協定によって日本市場は開かれたものとなり、外国製品のシェアの向上も達成されたが、協定が無くなればこれが後戻りすることが懸念される。ダンピングについても、協定の枠が外れると再発するかも知れない。従って政府の関与を含めてこれまでの枠組みをなるべく残すようにしたい。多極的な枠組みでは物事が決まらないので、米日両国の「半導体会議 (Semiconductor Council; SC)」にすべきである。

第5回交渉（最終）：7月29日～8月2日、バンクーバにて

最終交渉は7月29日から再びバンクーバで行われることになり、初日の29日から30日、31日といろいろな形で公式、非公式の会談が重ねられた。日米双方の担当者のすべてが「タイムリミットの7月31日までに終わらせなければならない」という強い気持ちをシェアしていた。この間、政府間の話し合いも並行して進められたが、まずは民間合意を優先させようということになった。

しかし、31日になってもはかばかしい進展がなく、朝から夜へと時間のみが刻々と過ぎて行く。そして、タイムリミットの深夜が近づいて、両方の交渉団の顔に疲労の色が浮かんでくる。その時、一人の知恵者が「ここで時計を止めましょう」と提案、双方ともこの一言に力を得てさらに詰めの交渉が続けられた。

8月1日の早暁になり、あらかた議論が尽きたので、日米双方の政府・民間トップが集まって問題点を整理することになった。日本側は当時の塚原通産大臣、坂本審議官と私の3人。米国側はバーシェフスキー USTR (米国通商代表部) 代表、シャピロ氏 (USTR 高官) とウェーバ氏 (SIA 会長) の3人。このトップ会談において、論点の整理が行われ、詳細の文言を詰める作業に移ることになる。そして最終合意に達したのが8月2日の早朝だったのである。

あくまでも7月末日までの決着を目指した交渉当事者にとって8月という月はいりえない。ある知恵者の妙案によってバンクーバ交渉は「7月31日の決着」となったのである。

実は最後まで妥協点が見つからず、完全合意に到らなかった点がある。それは新しい枠組みを日本主張の「世界半導体会議(WSC)」と称するか、米国主張の「半導体会議(SC)」と称するかという点である。日米双方ともこの点は最後まで譲ることができなかったのだ。幸に、この場合にも知恵者がいて双方の面子を立てるための妙案が出された。つまり、新しい枠組みは日本語では「世界半導体会議」と表現され、英語では「Semiconductor Council」と表現されることになったのである。難航した交渉の一断面を示すエピソードといえよう。

さて、新しい枠組みの第1回の会合が翌97年4月にハワイで行われた。この時点では欧州と韓国の半導体業界も参加することになったため「世界半導体会議(WSC)」と呼ぶことに米国側も同意したのである。WSCはその後、開催場所を変えながら毎年開催されており、世界の半導体業界のトップが顔を合わせて相互理解を深める機会となっている。

96年7月のバンクーバ会議は私の長い半導体人生の中で、忘れることのできない難しい交渉であった。しかしそれは世界の半導体業界にとってWSCの創設という歴史的な役割を果たしたということができる。

つづく

ここに掲載した記事は、2006年7月12日から2008年1月9日まで、半導体産業新聞に掲載されたものをウェブ用に再編集したものです。
--